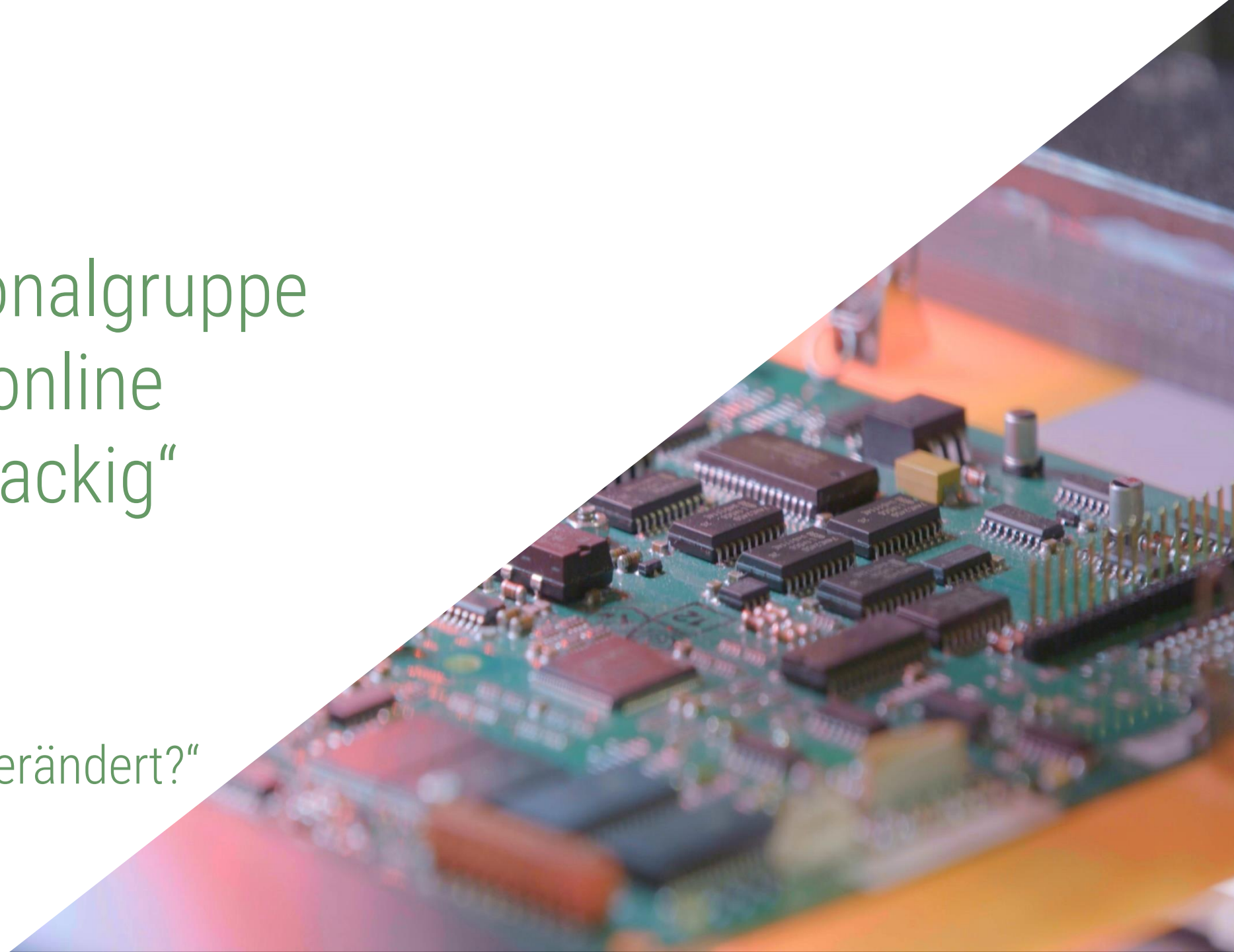


**FED**

Fachverband für Design,  
Leiterplatten- & Elektronikfertigung

# FED Regionalgruppe Stuttgart online „kurz & knackig“

Teil 2:  
„IPC-4101E,  
was hat sich verändert?“



# Das heutige Team



**Michael Matthes**

Moderator  
FED Regionalgruppenleitung  
Stuttgart

[michael.matthes@wittenstein.de](mailto:michael.matthes@wittenstein.de)



**Roland Schönholz**

Referent  
Technisches Marketing,  
Technolam GmbH  
FED Regionalgruppenleitung  
Stuttgart

[roland.schoeholz@conselix.de](mailto:roland.schoeholz@conselix.de)



**Yili Zhao**

Organisation  
Veranstaltungsmanagement  
FED

[y.zhao@fed.de](mailto:y.zhao@fed.de)

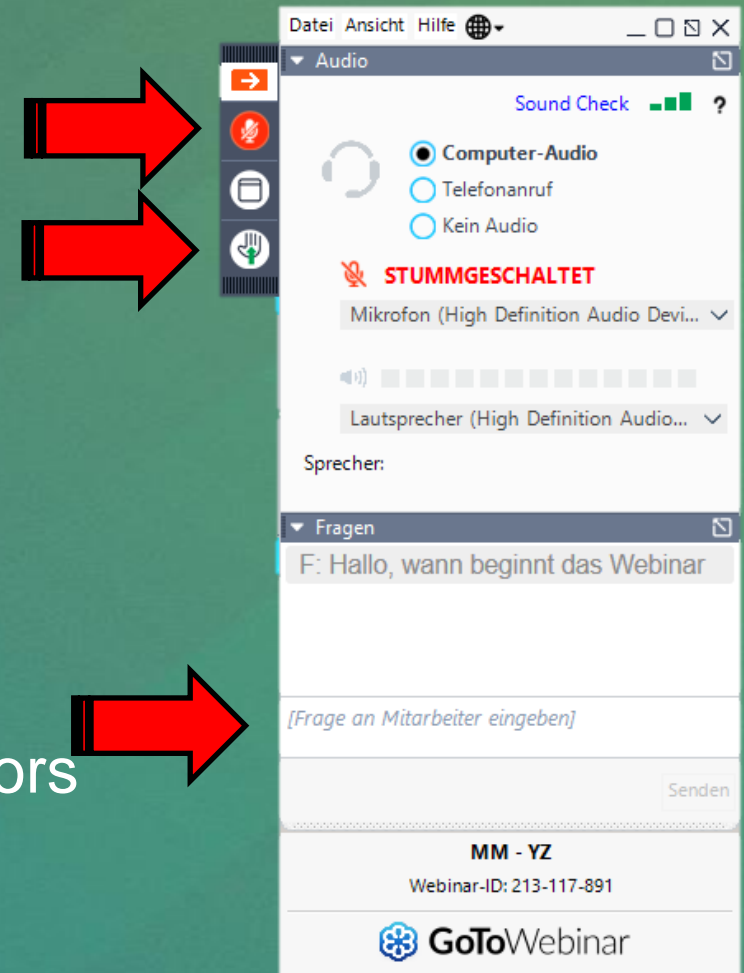
# Die Idee

„kurz & knackig“ in der RG-Stuttgart

- kontinuierliche Pflege des Netzwerkes in Zeiten von Corona
- Versorgung der Mitglieder mit kurzen, aktuellen Infos
- Einbinden der Mitglieder in gemeinschaftliche Aktivitäten
- Verkleinerung der Distanz durch Online-Sessions
- Vergrößerung des Teilnehmer- und Referentenkreises

# Kurze Einführung in GoToWebinar

- Stummschaltung der Teilnehmer
- Frage-Funktion während der Präsentation und Beantwortung der Fragen am Ende oder über Handhebe-Funktion just in Time und mit Audioübertragung
- Session wird aufgezeichnet
- Videoübertragung des Referenten und Moderators



# Heutiges Webinar

**IPC-4101E**  
2017 - March  
**Specification for Base Materials  
for Rigid and Multilayer  
Printed Boards**  
Supersedes IPC-4101D-WAM1  
July 2015  
*An international standard developed by IPC*

**13.05.2020 16:00 Uhr**

**„IPC-4101E,**

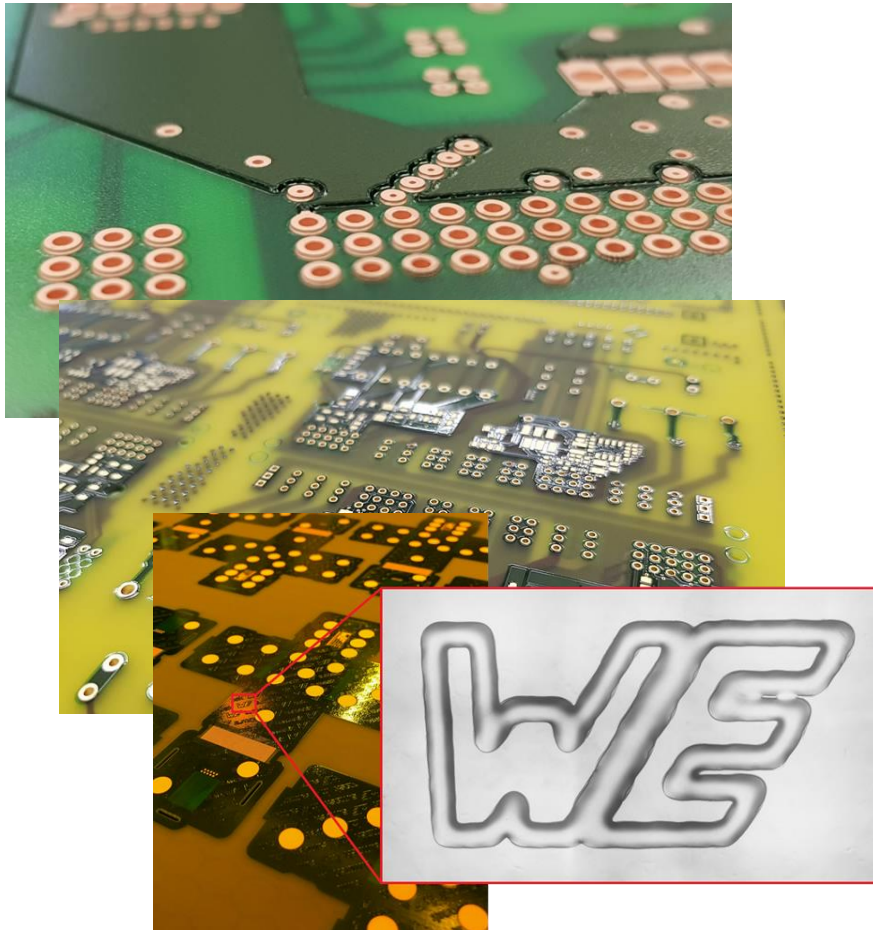
**was hat sich verändert?“**

**Referent: Roland Schönholz – Technisches Marketing,  
Technolam GmbH**

Association Connecting Electronics Industries



# Nächstes Webinar



**03.06.2020 16:00 Uhr**

## **„Überblick zur Lötstoppmaske in digitaler Additivtechnik bis hin zur funktionellen 3D- Oberfläche“**

**Referent: Jürgen Wolf – Technischer Manager, Würth  
Elektronik**

# Übernächstes Webinar

**FINE LINE**  
EXCELLENCE IN PCB

LEITERPLATTEN  
KUPFER INLAY / COIN, KUPFER INSERT  
TECHNOLOGIE

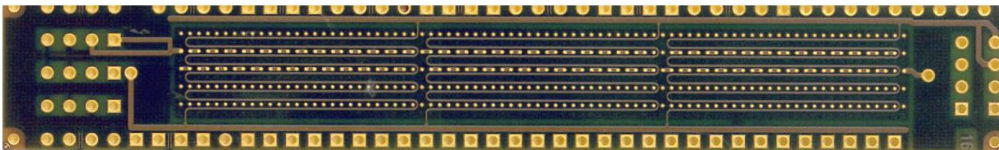
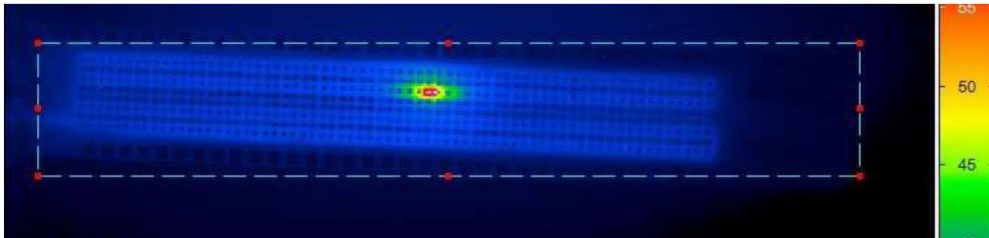
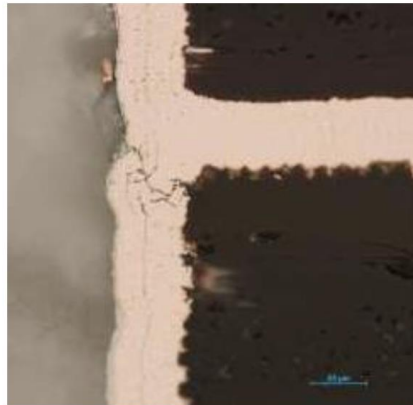
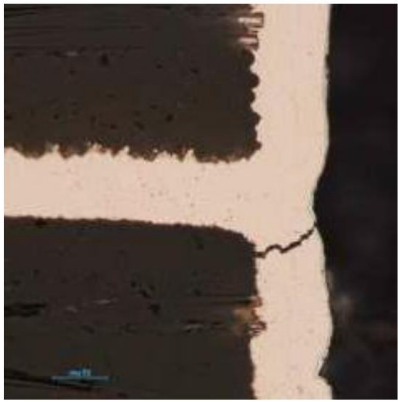
Albert Schweitzer  
© Copyright Fine Line  
Fine Line Gesellschaft  
für Leiterplattentechnik mbH  
Itterpark 4, D-40724 Hilden

**24.06.2020 16:00 Uhr**

**„ Leiterplatten Kupfer Inlay /  
Coin, Kupfer Insert  
Technologie“**

**Referent: Albert Schweitzer – Fine Line Gesellschaft für  
Leiterplattentechnik mbH**

# weitere Termine



**15.07.2020 16:00 Uhr**

**„Zuverlässigkeitsanalysen im  
Bereich hochkomplexer  
Leiterplatten“**

**Referent: Dr.-Ing. David Kurzmanowski  
Würth Elektronik GmbH & Co. KG**



weitere Termine

- **Sommerpause**

**und dann geht's weiter**

- **23.09.2020 16:00 Uhr**

Thema und Referent steht noch nicht fest





Fachverband für Design,  
Leiterplatten- & Elektronikfertigung

# Wir verbinden

---

FED e. V.  
Frankfurter Allee 73C  
10247 Berlin  
Tel. +49(0)30340603050  
[info@fed.de](mailto:info@fed.de)  
[www.fed.de](http://www.fed.de)

